

## 杭州立昂微电子股份有限公司 2021年前三季度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为37,226.75万元至41,145.36万元，同比增长184.48至214.42%。

● 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,417.36万元至38,040.24万元，同比增长278.99%至318.88%。

### 一、本期业绩预告情况

#### （一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年9月30日。

#### （二）业绩预告情况：同比上升

1、经财务部门初步测算，预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为37,226.75万元至41,145.36万元，与上年同期相比，将增加24,140.82万元至28,059.43万元，同比增长184.48至214.42%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,417.36万元至38,040.24万元，与上年同期相比，将增加25,336.04万元至28,958.92万元，同比增长278.99%至318.88%。

#### （三）本次预计的公司业绩未经注册会计师审计。

## 二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：13,085.93万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：9,081.32万元。

（二）每股收益：0.36元/股。

## 三、本期业绩预增的主要原因

### （一）主营业务影响

报告期内，受到国家政策驱动、“疫情经济”、半导体国产替代加快以及智能经济快速发展带动的下游需求持续增加，公司所处行业细分领域市场景气度不断提升，市场需求旺盛，公司销售订单饱满，主要产品产销量大幅提升，产品结构得到优化，加强成本费用管控力度，产品涨价等因素影响，公司营收同比大幅增长，盈利能力显著提升。

1、公司之前较早布局且完成了6英寸、8英寸硅片新产线建设，实施了功率器件芯片制造产线的产能技改提升，较为充分地满足了目前不断趋热的市场需求，公司各生产线满负荷运转，销售订单饱满，主要产品产销量大幅提升。

2、公司持续加大新产品新技术的开发力度，持续推进优质客户开拓，并加大与战略级客户的合作力度，进一步优化了产品结构。12英寸硅片方面，经过前期的客户拓展和产品验证，技术能力已覆盖14nm以上技术节点逻辑电路，功率器件及图像传感器件覆盖客户所需技术节点且已大规模出货；8英寸硅片产销量进一步放大，市场占有率进一步提升；半导体功率器件芯片方面，车规级功率器件芯片、光伏用旁路二极管控制芯片产销量大幅提升；化合物半导体射频芯片产销量也稳步提升。

3、公司通过管理提升和精益化生产，在技术改进、良率提升和成本费用控制节约等方面成果显著，有效的提升了产能与品质，降低了成本费用，增强了公司的盈利能力；

4、公司依据市场供需状况，适时进行了产品价格调整。

## （二）非经常性损益的影响

公司本报告期内非经常性损益有所减少，主要是政府补助减少所致。

## 四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

## 五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年三季度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2021年10月12日